

Product Overview

SK-AM62P-LP 设计包文件夹和文件列表



表 1 列出了 SK-AM62P-LP 中包含的文件夹名称、文件夹中的文件名称以及所有文件的格式。SK-AM62P-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (SKEVM) 基于我们的 AM62P 显示处理器 (17mm x 17mm、0.65/0.8mm 间距、采用 VCA 以及 466 引脚 FCBGA 封装) 而构建, 该处理器包含可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式特性, 如三路高清显示支持、高性能 3D-GPU、4K 视频加速。产品概述文档位于 TI.com 上的 SK-AM62P-LP 产品文件夹中, 供客户在下载单个 zip 文件夹之前查看。

表 1. Proc164E1.1

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	文件	文件类型
----	----	Proc164E1.1_Folders_Files_List	XLS
1_SCHEMATIC	PDF	PROC164E1-1_SCH_With_Design-Updates..Notes_V1.0	PDF
	PDF -Backup_SK_Schematic	PROC164E1-1_SCH	PDF
	----	Proc164E1-1_Schematic_Revision_Readme	DOC
	ORCAD	PROC164E1-1_SCH_With_Design-Updates..Notes_V1.0	DSN
	ORCAD - Backup_SK_Schematic	PROC164E1-1_SCH	DSN
2_BOM	----	PROC164E1-1_BOM_With_Design_Updates..Notes_V1.0	XLS
	Backup_SK_Schematic_BOM	PROC164E1-1_BOM	XLS
3_Board_File	Allegro	PROC164E1-1_BRD	BRD
	Simulation Scorecard	AM62x_Simulations_Scorecard	PDF
	Altium_ASCII	PROC164E1-1_BRD	ALG
4_Gerber	ODBGBR	PROC164E1-1_ODBGBR	ZIP
	274X	PROC164E1-1_274XGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC164E1-1_IPC	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC164E1-1_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC164E1-1_ALL_LAYER	PDF
	Geber Layers	PROC164E1-1_ALL_LAYER	PDF
6_Assembly_Models_Package	2D	PROC164E1-1_DXF_BASY	DXF
		PROC164E1-1_DXF_TASY	DXF
	3D	PROC164E1-1_3D.STEP	STP
	IDF	PROC164E1-1_BRD	EMP
		PROC164E1-1_BRD	EMN
	Assembly_Drawing	PROC164E1-1 ASSEMBLY	PDF
		PROC164E1-1_TASY	PDF
		PROC164E1-1_BASY	PDF
	STNL	art_aper + 8 x .ART 文件	ART
	XY-REP	PROC164E1-1_XY-REP	XLS
7_PCB_LAYER_STACKUP	---	AM62P SKEVM_STACKUP-12L-2-5-2023[0592]	PDF
8_Power_Supply_Sequencing	---	Proc164E1.1_SK-AM62P_LP_Power Sequence_RevE1.1	PDF

参考资料

- 德州仪器 (TI), [\[常见问题解答\] AM62P/AM62P-Q1 - 定制电路板硬件设计 - 用于重复使用 SK-AM62P-LP 原理图的设计和审阅说明](#) 文章

商标

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司